

平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和
(コード番号 6315 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 本 部 長 柴 原 信 隆
TEL (075) 692 - 0251

新製品「PMC2030-D」販売開始に関するお知らせ

当社は、半導体製品の厚み精度および装置内クリーン度を向上した、当社独自技術のコンプレッション装置『PMC2030-D』を開発し、販売を開始することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 開発背景

半導体製品が薄型化していく状況において、製品の厚みバラツキを極小化させるとともにコンタミネーション（パッケージに埃や塵などの異物が混入すること）の問題に対応した半導体製造装置の要求が高まっております。

今回、販売を開始するコンプレッション装置『PMC2030-D』は、プレス機構の平坦度や樹脂供給機構の精度向上を図ることにより、半導体製品の厚みバラツキを従来の $\pm 30 \mu\text{m}$ から $\pm 10 \mu\text{m}$ に抑えることを可能といたしました。また、装置内の気流をコントロールすることにより、装置内クリーン度 Class1000 を実現し、コンタミネーションの問題にも対応いたしました。

これにより低圧成形で製品の厚み精度が要求されるメモリーやセンサー関係など幅広い半導体製品の生産において当社独自技術のコンプレッション装置『PMC2030-D』が活躍するものと考えております。

2. 新製品の概要

(1) 製品名

PMC2030-D

(2) 製品の特徴

- ・半導体製品の厚み精度 $\pm 10 \mu\text{m}$ を実現
- ・装置内のクリーン度 Class1000 を確保
- ・生産性を従来機種比で 30% 向上



(3) 販売計画

- ・販売開始時期 2018 年 6 月
- ・販売目標 年間 15 台 (2019 年 3 月期)

以 上